

ピックアップテーマ

「次世代パワーデバイスの最新動向と
回路設計最前線」
「AIデータセンターを支える
次世代電源とパワーデバイス」

■特集期間： 2026年10月26日（月）～12月25日（金）（予定）

■お申込み締切：2026年10月2日（金）

ピックアップテーマとは

EE Times Japan／EDN Japan編集部が注目するテーマについて、特集ページを開設メディアと連携した企画展開で、貴社商材をエレクトロニクス読者者・会員に訴求します



特集ページを開設

編集部が注目するテーマについて特集ページを開設します。貴社コンテンツに加えて編集部による解説や関連する編集記事を掲載して、専門性が高く情報収集に熱心な読者に情報発信をします。



認知向上も実現

EE Times Japan／EDN Japan／MONOistからのバナー広告枠を利用し、本特集ページへ誘導をかけます。また特集ページには貴社ロゴを掲載いたします。通常のリード獲得案件より製造業での認知向上も実現できます。



コンテンツ制作付き お得なプラン

本特集ならではの費用対効果を見込めるお得なプランを用意しております。PRする絶好の場として、本特集をご活用いただけますと幸いです。

特集展開イメージ

メディア上から誘導



特集ページを新設



貴社コンテンツへ誘導



リード納品

獲得したリードは管理サイトでダウンロードできます（日次更新）



関心・専門性の高い会員を誘導

TechFactory、EE Times Japan/EDN Japanを中心とする当社運営の製造業向けメディア会員へメールで貴社コンテンツへ誘導いたします



特集テーマ:次世代パワーデバイスの最新動向と回路設計最前線

AIや電動化に伴う深刻な電力課題を解決に導く SiC・GaNの最新動向から、熱・ノイズ対策などの回路設計を特集

カーボンニュートラルや省エネの実現に向け、電力変換効率を高めるパワーエレクトロニクス的重要性が増えています。しかし、従来のシリコン半導体では効率化や小型化の向上に限界があり、熱・ノイズ対策や信頼性確保を含めた高密度化への対応が大きな課題です。そこで不可欠となるのが、次世代パワー半導体（SiC／GaN）の活用と、それを支える材料・製造プロセス・回路設計技術の進化です。急速に普及するAIデータセンターや電動化に伴う深刻な電力課題に対し、高効率な次世代パワーデバイスへの期待が高まっています。本特集では、パワーデバイスやモジュールの最新情報の他、SiC／GaN採用に伴う回路設計、熱やノイズ対策、信頼性評価などの動向や、加工／製造プロセス技術の動向を特集します。

キーワード

パワーデバイス、SiC／GaNパワー半導体、パワーモジュール、ウェハー加工、半導体材料、熱設計、ノイズ対策、制御回路 など

読者・会員 課題

パワーデバイス採用に伴う回路設計とノウハウ不足、パワーデバイスに関する最新動向把握 など

想定リード属性

電子回路設計者、電子機器開発者、自動車/産業機器開発者、パワーデバイス開発者

実施メディア

TechFactory／EE Times Japan

実施期間

2026年10月26日（月）～12月25日（金）予定

申込締め切り

2026年10月2日（金）

提供リード数

70件保証～（プラン毎に異なります）

料金

50万円～（プラン毎に異なります）

特集ページ イメージ



貴社ロゴ掲載

ご協賛社様コンテンツ掲載

制作したタイアップ記事や貴社製品・ソリューションに関するホワイトペーパーやウェビナーを掲載

関連記事掲載

テーマに関する最新事例などを紹介した編集記事を掲載

特集テーマ:AIデータセンターを支える次世代電源とパワーデバイス

AI普及に伴うデータセンターの深刻な電力課題に挑む 800V直流給電やSiC/GaN、最新の冷却技術を集集

生成AIをはじめとするAI技術の急速な普及に伴い、データセンターの消費電力増大が深刻な課題となっています。特に最新のGPU搭載サーバは膨大な電力を必要とし、従来の給電方式では電力変換ロスが増大や、それに伴う発熱の処理が限界に達しています。そこで不可欠となるのが、電力損失を最小化する「800V直流アーキテクチャ」など次世代のデータセンター用電源アーキテクチャと、高効率化を実現するSiC/GaNパワーデバイスの適用、そして冷却技術の融合です。電力供給の最適化と熱対策の両立は、ITインフラの省エネ化と安定稼働に欠かせません。本特集では、AIデータセンターの電力課題を解決する次世代電源やデバイスを中心に最新技術を集集します。

キーワード	AIデータセンター、電力消費、DCアーキテクチャ、800V直流アーキテクチャ、電力供給、サーバ、サーバ用電源、電源モジュール、SiC/GaNパワー半導体、冷却技術、液冷/液浸
読者・会員 課題	電源アーキテクチャの最新動向把握、高発熱化するGPU・設備に対する冷却技術 など
想定リード属性	電源設計エンジニア、半導体メーカー、サーバ設計者/サーバメーカー、DC事業者、ITインフラ担当者、情シス/クラウド基盤担当者
実施メディア	TechFactory/EE Times Japan
実施期間	2026年10月26日（月）～12月25日（金） 予定
申込締め切り	2026年10月2日（金）
提供リード数	70件保証～（プラン毎に異なります）
料金	50万円～（プラン毎に異なります）

特集ページ イメージ

貴社ロゴ掲載

ご協賛社様コンテンツ掲載

制作したタイアップ記事や貴社製品・ソリューションに関するホワイトペーパーやウェビナーを掲載

関連記事掲載

テーマに関する最新事例などを紹介した編集記事を掲載

ご協賛プラン

	ゴールドプラン	シルバープラン	ブロンズプラン
	ゴールドプラン ¥1,000,000 (38万円OFF)	シルバープラン ¥800,000 (26万円OFF)	ブロンズプラン ¥500,000 (16万円OFF)
ご提供リード数 ・セグメント条件の設定はありません	160件保証	120件保証	70件保証
コンテンツ数 ※お手持ちのコンテンツ（ホワイトペーパー／動画）をご用意ください	2本	2本	2本

- ※ 料金は税別、グロスです。
- ※ ホワイトペーパーをお持ちでない場合、別途費用が発生しますが制作プランがありますので、担当営業までご相談ください。
- ※ プランのカスタマイズも可能です。担当営業までご相談ください。
- ※ ご協賛状況により、実施見合わせとなる可能性がありますので、予めご了承ください。
- ※ リード獲得期間は2カ月間を想定しています

スケジュール

以下日程で貴社コンテンツ掲載・特集ページの制作準備をいたします
コンテンツ（タイアップ記事／ホワイトペーパー）制作をお申込みの場合、
日程は担当営業までお問合せください



※上記は標準時のスケジュールとなり、校正の回数が増える場合や特別対応の場合、上記と異なる場合もございます

※取材日、貴社コンテンツの支給が締め切りより大幅に遅れた場合、特集ページに掲載されない場合がありますので、ご了承ください



■お問い合わせ

アイティメディア株式会社 営業本部
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12
紀尾井町ビル 13階

<https://promotion.itmedia.co.jp/contact>